รายงาน

เรื่อง คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

จัดทำโดย

นาย คณาพงษ์ ศิริประชัย 61070019 นาย กิตติพศ ละอองศรี 61070014 นาย ธิติวุฒิ โพธิ์พันธุ์ 61070088

เสนอ

ดร. อนันตพัฒน์ อนันตชัย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา

computer system organization and operating system รหัสวิชา 06016320

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

รายงาน นี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายการทำงานของแต่ละชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์และอธิบาย กระบวนการทำงานของส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการ ใด ผู้จัดทำขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

ผู้จัดทำ

นายคณาพงษ์ ศิริประชัย นายกิตติพศ ละอองศรี นาย ธิติวุฒิ โพธิ์พันธุ์ วันที่ 24/ 4/ 62

สารบัญ

บทหำ	1
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	2
CPU (Central processing unit)	2
คุณสมบัติ AMD Ryzen 3 1200	6
Mainboard	9
คุณสมบัติ ASROCK ZB350M-HDV	10
VGA (การ์ดจอ)	13
คุณสมบัติ INNO3D Geforce DTX1050Ti TWIN X2	13
Memory (ram)	14
กุณสมบัติ KIMGSTON Hyper-X Fury DDR4 8GB 2666 Black	16
Harddisk	17
กุณสมบัติ SEAGATE BARRACUDA 1TB	17
SSD	18
กุณสมบัติ Western Digital WD GREEN M.2 240GM	18
Power supply	19
กุณสมบัติ COOLERMATSTER MWE 550	19
Cpu cooler	20
Case	20
บรรณานุกรม(แหล่งอ้างอิง)	21
กาดผนาก	22

บทน้ำ

รายงานนี้จะมาอธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยจะนำตัวอย่างสเปคของคอมพิวเตอร์มา อธิบายการทำงานของอุปกรณ์และระบบในการทำงานและข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์ โดยตัวอย่าง คอมพิวเตอร์ที่จะอธิบายมีองค์ประกอบดังนี้

1.	CPU	AMD Ryzen 3 1200
2.	Mainboard	ASROCK ZB350M-HDV
3.	VGA Card	INNO3D GTX1050Ti Twin X2 4GB
4.	Memory(ram)	KIMGSTON Hyper-X Fury DDR4 8GB 2666 Black
5.	Harddisk	SEAGATE BARRACUDA 1TB
6.	Solid state Drive(SSD)	Western Digital WD GREEN M.2 240GM
7.	Power Supply	COOLERMATSTER MWE 550
8.	CPU Cooler	-
9.	Case	AERO COOL CS-1101(Black)

Ryzen 3 1200 / GTX1050Ti Twin X	2
AMD Ryzen 3 1200	2,700
ASROCK AB350M-HDV	1,450
INNO3D GTX1050Ti Twin X2 4GB <u>x 1</u>	3,890
KINGSTON Hyper-X Fury DDR4 8GB 2666 Black X	<u>1</u> 1,770
SEAGATE BARRACUDA 1TB <u>x 1</u>	1,165
Western Digital WD GREEN M.2 240GB <u>X 1</u>	1,080
COOLERMASTER MWE 550	1,350
AERO COOL CS-1101 (Black)	790
TOTAL PRICE 14,	195

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

CPU (Central processing unit)

CPU (หน่วยประมวลผลกลาง) เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยภายใน CPU จะ ประกอบไปด้วย

- ALU (หน่วยคำนวณและตรรกะ) เป็นหน่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่คำนวณทาง คณิตศาสตร์ (Arithmetic operations) และการคำนวณทางตรรกศาสตร์ (Logical operations) โดยปฏิบัติการเกี่ยวกับการคำนวณได้แก่ การบวก (Addition) ลบ (Subtraction) คูณ (Multiplication) หาร (Division)
- Control unit (หน่วยควบคุม) เป็นหน่วยควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหน่วยทุกๆ หน่วย ใน CPU และอุปกรณ์อื่นที่ต่อพ่วง เปรียบเสมือนสมองที่ควบคุมการทำงานส่วนประกอบ ต่าง ๆ และควบคุมให้หน่วยรับข้อมูลรับข้อมูลเข้ามาเพื่อทำการประมวลผล ตัดสินใจว่าจะให้ เก็บข้อมูลไว้ที่ไหน ถูกต้องหรือไม่ ควบคุมให้ ALU ทำการคำนวณข้อมูลที่รับเข้ามา ตลอดจน ควบคุมการแสดงผลลัพธ์
- Registers (รีจีสเตอร์) คือ แหล่งที่ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีลักษณะคล้ายกับหน่วยความจำ แต่ มันจะถูกแยกออกมาต่างหาก รีจีสเตอร์จะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลแบบพิเศษที่ทำให้ CPU สามารถ ดึงข้อมูลไปใช้งานได้เร็วกว่าหน่วยความจำธรรมดา รีจีสเตอร์อยู่ใน CPU และถูกจัดการโดย CU ถ้าแบ่งรีจีสเตอร์ตามหน้าที่จะแบ่งได้เป็น
 - 1. Accumulator Register ทำหน้าที่เก็บผลลัพธ์จากการคำนวณ
 - 2. Instruction Register ทำหน้าที่เก็บคำสั่งในโปรแกรมที่กำลังจะถูกประมวลผล
 - 3. Address Register ทำหน้าที่เก็บที่อยู่ (address) ของคำสั่งหรือชิ้นข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ใน หน่วยความจำ
 - 4. Storage Register ใช้เก็บข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาจากหน่วยความจำ หรือผลลัพธ์จากการ ประมวลผลที่ถูกส่งไปเก็บยังหน่วยความจำ
 - 5. General-purpose Register ใช้ทำงานหลายอย่าง แล้วแต่โปรแกรมจะเรียกใช้

 Internal Bus (บัส) คือ เส้นทางที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆเข้า ด้วยกัน และส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยวงจรทาง ไฟฟ้าที่เรียกว่าบัส

ส่วนประกอบของระบบบัส

- 🔾 เส้นทาง หมายถึง เส้นทางที่ข้อมูลเดินผ่าน ส่วนใหญ่จะสังเกตเป็นเส้นบนเมนบอร์ด
- O ชิปควบคุม ทำหน้าที่ บริหารการเข้าใช้บัสของชิ้นส่วนต่าง ๆ และทำ หน้าที่ป้องกัน ปัญหา ขัดแย้ง เนื่องจากการแย่งใช้บัสในเวลาเดียวกัน
- O สล็อตต่อขยาย อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าระบบบัสไม่ใช่แค่สื่อสารระหว่างชิ้นส่วนภายใน เครื่องพีซีเท่านั้น ยังสื่อสารกับการ์ดเสริม

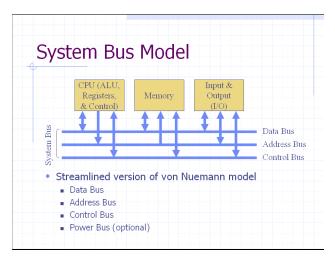
ผลของความเร็วบัส

 บัสเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์กับแรม แรมกับฮาร์ดดิสก์ แรมกับการ์ดต่าง ๆโดยรวมของ ไมโครคอมพิวเตอร์ ยิ่งบัสมีความเร็วสูงเท่าใดและมีจานวนบิตมากขึ้นเท่าใด ก็จะ ทำ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เร็วขึ้น

อุปกรณ์ที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วบัส

- O หน่วยความจำ หลัก (RAM)
- O External Static RAM (แคชบนเมนบอร์ด)
- O การ์ดควบคุมการแสดงผล (VGA Card)
- การ์ดเพิ่มขยาย
- อาร์ดดิสก์ (Harddisk)
- O ชิปเซต (Chipset)

- O บัสตำแหน่ง (Address Bus) เป็นบัสที่ส่งตำแหน่งของข้อมูล
- O บัสควบคุม (Control Bus) เป็นส่วนที่นาคาสั่งควบคุม และ คำสั่งสาหรับติดต่อกับ อุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมการทำงานให้จังหวะในส่วนต่าง ๆ เช่น สัญญาณ อ่าน/เขียน การร้องขอการขัดจังหวะ สัญญาณนาฬิกา
- O บัสข้อมูล (Data Bus) เป็นบัสในการสง่ข้อมูล



system Bus Model

การทำงานของบัส

เมื่อ BUS เป็นเส้นทางการส่งข้อมูลที่เป็นสัญญานไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ของ เรา ดังนั้นก็จะมี วงจร สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ BUS เรียกว่า BUS Controller ซึ่งในอดีต มี Chip IC ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงแยกออกไป ในปัจจุบัน ได้มีการ รวมวงจร ควบคุม BUS นี้เข้าไว้ใน North Bridge Chip โดยที่วงจรควบคุมระบบ BUS นี้จะทำหน้าที่ จัดช่องสัญญานประเภทต่างๆให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ บนเมนบอร์ดให้กับอุปกรณ์ ที่ร้องขอใช้งาน เช่น CPU, อุปกรณ์ I/O, Port ต่างๆ เป็นตัน

โครงสร้างการทำงานของระบบบัสภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบันนั้น โดยทั่วไปได้มี การแบ่งการทางานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

O ระดับที่ 1 Host Bus

คือ จะทำหน้าที่ควบคุมการสื่อสาร การส่งถ่ายข้อมูล และควบคุมการทรานแอกชั่น ข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์ (CPU) ของระบบ และ ตัวควบคุม PCI ในส่วนที่ทำหน้าที่เป็น North Bridge ซึ่งมีอัตราการทรานแอกชั่นข้อมูลที่มี ความเร็วสูงมาก ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์ใน North Bridge คือ หน่วยความจำ Cache และหน่วยความจำหลักของระบบ ซึ่งควบคุมการแลกเปลี่ยน ข้อมูลจะเกิดขึ้นภายใน Chip Set ทำหน้าที่ควบคุม North Bridge

O ระดับที่ 2 PCI Bus (Peripheral Component Interconnect)

คือ ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อตามมาตรฐานการ เชื่อมต่อแบบ PCI ซึ่งอุปกรณ์ในระบบ PCI เมื่อจะทำการติดต่อกับ Processor หรือ ระบบหน่วยความจำที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ North Bridge ซึ่งจะควบคุมการส่งผ่าน ข้อมูล และ จำนวนทรานแอกชั่นของข้อมูลให้มีความเร็วที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ สื่อสารกันได้ โดย Chip Set จะทำหน้าที่ควบคุมในส่วนนี้เช่นกัน

O ระดับที่ 3 ISA Bus (Industry Standard Architecture)

คือ ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ I/O ต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อมาตรฐาน ISA ซึ่งอุปกรณ์ที่มีการ ต่อแบบ ISA ยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน อีกหลายชนิด และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบ ISA จะมีความเร็วต่ำที่สุดของภายในระบบ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ การทราน แอกชั่นของข้อมูลจะช้า และ ต้องติดต่อกับ Chip Set ที่ทำหน้าที่ควบคุมในส่วนนี้ ซึ่ง ถูกเรียกว่า South Bridge เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการเสียหายของข้อมูลในขณะที่มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ I/O ที่ความเร็วสูงกว่า และนอกจาก South Bridge ยังมีหน่วย ควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบด้วย เช่น ระบบอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ IDE หรือ ระบบมัลติมีเดีย เป็นตัน

คุณสมบัติ AMD Ryzen 3 1200

Os support

window10 - 64bit Edition

RHEL x86 64-Bit

Ubuntu x86 64-Bit

Of 4 core

คือหน่วยประมวลผลที่มีการทำงานถึงสี่ core เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การทำงานให้ทำงาน

สบายขึ้น ซึ่งแต่ละแกนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการประมวลคำสั่งต่างๆ ที่เข้ามา

Thread

เธรด หรือ Thread of Execution คือคำศัพท์เชิงซอฟต์แวร์สำหรับลำดับคำสั่งพื้นฐานของคำสั่งที่

สามารถพาสทรูหรือประมวลผลด้วยหนึ่งแกนประมวลผล CPU ซึ่ง AMD Ryzen 3 1200 มี 4

thread

Base Clock and Maxboost clock

ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์แสดงอัตราที่เกิดการเปิดและปิดของทรานซิสเตอร์ของโปรเซสเซอร์

ถูกกำหนด ความถี่จะถูกวัดเป็นกิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือหนึ่งพันล้านรอบต่อวินาที ซึ่ง Base Clock

ของ AMD Ryzen 3 1200 มี 3.4GHz และ Maxboost clock มี 384GHz

Total cache

L1 L2 L3 คือแรมที่มีความเร็วสูงมากๆ เอาไว้ให้ CPU Reader/Write เพื่อทำเป็นบัฟเฟอร์เพราะ

การที่ CPU Read/write กับแรมภายนอกตรงๆมันจะช้ามากเนื่องจากความเร็วในการทำงานของ

แรมภายนอกที่ช้ากว่า CPU มากๆ จึงเอาแรมพวกนี้มาคั่นเอาไว้เป็นบัฟเฟอร์ระหว่างแรมภายนอก

Total L1 cache: 384KB

Total L2 cache: 2MB

Total L3 cache: 8MB

7

CMOS

CMOS (ซีมอส) ย่อมาจาก "Complementary Metal Oxide Semiconductor" เป็นชิปไอซีที่ใช้เก็บ ข้อมูลที่เป็นค่าเฉพาะของแต่ละระบบ เพื่อให้ Bios (ไบออส) นำไปใช้ในการบู๊ตระบบ ข้อมูลที่ถูกเก็บ อยู่ใน CMOS เช่น เวลา และวันที่ของระบบ ค่าของฮาร์ดดิสก์ และใดรว์ซีดี/ดีวีดี, การปรับค่า

ความเร็วในการอ่านเขียนของแรม เป็นต้น เป็นชิปสารกึ่งตัวนำที่ถูกติดตั้งแบบออนบอร์ดมากับ เมนบอร์ดเลย เราจะมองไม่เห็นตัวชิปเพราะมันถูกผนวกเข้ากับชิปเซ็ต ชิป CMOS เป็น

หน่วยความจำที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กินไฟน้อย และทำงานได้เร็ว ซึ่ง CMOS ของ AMD

Ryzen 3 1200 คือ 14nm

PCI Express Version

Bus Interface ต่อการ์ดจอ PCIe 3.0 x 16 slot

Thermal Solution: Wraith Stealth

AMD Ryzen 3 มาพร้อมชุดระบายความร้อน Wraith Stealth ทั้งใน AMD Ryzen 1300X และ Ryzen 1200 ซึ่งเป็นโซลูชั่นระบายความร้อนของเอเอ็มดีที่มีประสิทธิภาพ และทำงานได้เงียบ และ เป็นชุดระบายความร้อนตัวเล็กสุดในระบบระบายความร้อนตระกูล Wraith ที่ปกติแล้วจะติดตั้งให้

เฉพาะกับคู่ค้าเท่านั้น

Default TDP / TDP: 65w

คือค่าพลังงานสูงสุด ที่ซีพียูนำไปใช้งาน ภายใต้สภาวะการทดสอบผ่านโปรแกรมเฉพาะอย่าง

Max Temps: 95°C

System memory

System Memory Specification: 2667MHz

System Memory Type: DDR4

Memory Channels: 2

Key Features

- Supported Technologies : The "Zen" Core ArchitectureEnmotus FuzeDrive™ for AMD
 Ryzen™XFR (Extended Frequency Range)
- AMD SenseMI Technology AWX2
- AMD VR Ready Processors FMA3



AMD Ryzen 3 1200

Mainboard

เมนบอร์ด (Mainboard) คือ ศุนย์กลางของการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มี ชิปเซตที่ทำหน้าที่รับ/ส่งข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกขั้นหนึ่ง เมนบอร์ด (Mainboard)นิยมใช้ มาตรฐานการออกแบบ ATX (Advance Technology Extension) ปรับปรุงจากระบบเก่าที่เป็นแบบ Body AT โดยแบบใหม่จะมีการปรับปรุงบริเวณ ซีพียู(CPU)โดยจะย้ายไปไกลพัดลมของ แหล่งจ่ายไฟ(Power Supply) ทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

และล่าสุดนี้มีการพัฒนาแบบ BTX (Balance Technology Extension) ได้นำพัดลมมาไว้ด้านหน้า เคสเพื่อนำลมเย็นเข้าไปภายในระบบและนำซีพียู (CPU)มาไว้ด้านหน้าเครื่องเพื่อรับสมเย็นโดยตรง ส่งผลให้ไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมที่มีความเร็วรอบสูงและเสียงดัง ปัจจุบันเมนบอร์แบบ BTX ไม่ได้รับ ความนิยมเนื่องจากเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เคส ฮัตซิงค์ เป็นตัน

นอกจากเมนบอร์ดมาตรฐาน ATX (Advance Technology Extension) ปัจจุบันยังมีเมนบอร์ด มาตรฐาน Mini-ITX เป็นเมนบอร์ดขนาดเล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กเพื่อความบันเทิงหรือ HTPC และเคสก็ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อวาง LCD TV ตัวเมนบอร์ดจึงมีขนาดเล็กตามไป ด้วย เมนบอร์ดบอร์ดลักษณะนี้จะรวมทุกอย่างไว้บนเมนบอร์ดและมีเพียง 1 สล็อตเท่านั้น

ส่วนประกอบของเมนบอร์ดจะประกอบไปด้วย

- ซ็อกเก็ตซีพียู (CPU Socket)
- ชิปเซต (Chipset)
- ซ็อกเก็ตแรม (RAM Socket)
- สล็อตของการ์ดจอ (Graphic Card Slot)
- สล็อต PCI (PCI Slot)
- หัวต่อไดรว์ต่างๆ
- หัวต่อแหล่งจ่ายไฟ
- ชิปรอมไบออส (ROM BIOS)
- หัวต่อสายสวิตช์ควบคุม
- พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ

คุณสมบัติ ASROCK ZB350M-HDV

Support CPU

Socket: AM4 1000 Series, AM4 2000 Series, AM4 Athlon

• CPU Generation : AMD RYZEN series

รองรับการกินไฟ CPU : 65W

• Chipset: B350

CPU Series : AMD A Series , AMD Ryzen™ 3 , AMD Ryzen™ 5 , AMD Ryzen™ 7 ,
 Athlon

• OS support : window10

Memory

• จำนวน Slot แรม : 2

• ชนิดของแรม : DDR4

ความจุแรมสูงสุด : 32 GB

• Ram: Bus 2133, 2400, 2667, 2933 (OC), 3200 (OC)

Onboard

VGA Onboard : Integrated AMD Graphics in APU (actual support depend on CPU)

Audio Onboard : Realtek ALC887 Audio Codec

• รองรับระบบเสียง : 7.1 Channels

Storage Connector

Port SATA 2 : - Port

Port SATA 3: 4 Port

• รองรับฟังก์ชั่น RAID : 0/1/10 for SATA

• Port M.2 SSD: 1 (1 x PCle & SATA) Port

Expansion Slots

• Slot : 1 x PCle 2.0 x1 Slot , 1 x PCle 3.0 x16 Slot

Network

• Chipset LAN : Realtek 8111GR

• ความเร็ว LAN : 10/100/1000 Mbps

• Wi-Fi : -

Rear Panel Ports

• USB 2.0 : 2 Port

• USB 3.0 : - Port

• USB 3.1 : 4 Port

• Serial Port : - Port

• Dsub Output : 1 Port

• DVI Output : 1 Port

• HDMI Output : 1 Port

DisplayPort Output : - Port

Audio Output : 3 x Audio jacks Port

Port PS2: 1

Option Port : -

Physical Spec

• Form Factor : Micro-ATX

• ช่องเสียบไฟ : 24+4 Pin

● ขนาด : 23.1 x 20.6 cm



ASROCK ZB350M-HDV

VGA (การ์ดจอ)

VGA ย่อมาจาก Video Graphic Adapter มีหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณ digital ให้เป็นสัญญาณภาพ สำหรับแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งVGAจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเมนบอร์ดกับจอภาพ มี วประเภท

1. การ์ดจอออนบอร์ด (On-Board) คือการ์ดจอที่ถูกติดตั้งมาบนแผงวงจร Mainboard (เมนบอร์ด) โดยจะเป็นแผงวงจรเดียวกับ Mainboard ไม่สามารถถอดออกได้ และไม่สามารถอัพเกรดได้

2.การ์ดจอแยก (Out-Board) คือการ์ดจอลักษณะเป็นการแยกจาก Mainboard (เมนบอร์ด) โดย ชัดเจน เป็นคนละชิ้นส่วนกัน แต่การ์ดจอจะเสียบอยู่บนเมนบอร์ดในลักษณะการเชื่อมต่อภายนอก สามารถถอดเข้าถอดออกได้ และสามารถที่จะอัพเกรดเอาตัวใหม่มาใส่ได้

VGA จะช่วยให้หน้าจอสามารถแสดงผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนการทำงานของ ระบบ CPU ซึ่ง CPU จะต้องประมวลผลทุกๆส่วนของระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว

คุณสมบัติ INNO3D Geforce DTX1050Ti TWIN X2

CUDA Cores: 768

Base/base clock: 1290/1392 MHz

Memory Congfig: 4GB 128-bit GDDR5 7Gbps

Power Comnectors: GreemVersion - No power connector

Outputs: DP 1.2 + HDMI 2.0 + DL-DVH

Bunble: Driver Kit



INNO3D Geforce DTX1050Ti TWIN X2

Memory (ram)

RAM คือหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ (เป็นหน่วยความจำแบบชั่วคราว ซึ่งหมายถึงจะ สามารถทำงานได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยง

RAM สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. Input Storage Area

เนื้อที่ RAM ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจาก Input devices เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ Barcode reader และอื่นๆ โดยจะเก็บไว้เพื่อส่งให้ CPU ทำการประมวผล คำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นต่อไป

2. Working Storage Area

เนื้อที่ RAM ส่วนนี้เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผลของ CPU

3. Output Storage Area

เนื้อที่ RAM ส่วนนี้เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล คำนวณ และวิเคราะห์โดย หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU แล้วและอยู่ระหว่างรอส่งผลการประมวลดังกล่าวกลับคืนไปให้ โปรแกรมเจ้าของชุดคำสั่ง เพื่อแสดงผลทาง Output devices ตามที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้

4. Program Storage Area

เป็นส่วนที่ใช้เก็บชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการจะส่งเข้ามา เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม คำสั่งชุดดังกล่าว หน่วยควบคุมจะทำหน้าที่ดึงคำสั่งจากส่วนนี้ที่ละคำสั่งเพื่อทำการแปลความหมาย ว่าคำสั่งนั้นสั่งให้ทำอะไร จากนั้นหน่วยควบคุมจะไปควบคุมฮาร์ดแวร์ที่ต้องการทำงานดังกล่าวให้ ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ หน่วยความจำจะจัดอยู่ในลักษณะแถวแนวตั้ง (CAS:Column Address Strobe) และแถวแนวนอน (RAS:Row Address Strobe) เป็นโครงสร้างแบบเมทริกซ์ (Matrix) โดย จะมีวงจรควบคุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงจรในชิปเซต (Chipset) ควบคุมอยู่ โดยวงจรเหล่านี้จะส่ง สัญญาณกำหนดแถวแนวตั้ง และสัญญาณแถวแนวนอนไปยังหน่วยความจำเพื่อกำหนดตำแหน่ง ของข้อมูลในหน่วยความจำที่จะใช้งาน

RAM มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

แรมมือยู่ด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน เช่น

- SRAM (Static RAM)
- NV-RAM (Non-volatile RAM)
- DRAM (Dynamic RAM)
- Dual-ported RAM
- Video RAM
- WRAM
- FeRAM
- MRAM

RAM ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภทคือ

- SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- DDR RAM หรือ DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)

Module หรือ รูปแบบของ RAM ที่นิยมใช้มีดังนี้

- Single in-line Pin Package (SIPP)
- Dual in-line Package (DIP)
- Single in-line memory module (SIMM)
- Dual in-line memory module (DIMM)
- Small outline DIMM (SO-DIMM) เป็น DIMM ที่มีขนาดเล็ก ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล็บท็อป
- Small outline RIMM (SO-RIMM)

คุณสมบัติ KIMGSTON Hyper-X Fury DDR4 8GB 2666 Black

ความจุ 8GB, 16GB, 32GB และ 64GB (เป็นชุด)
ความเร็ว 2,133MHz, 2,400MHz, 2,666MHz
ค่าหน่วงเวลา CAS CL14-CL15
ใช้พลังงานต่ำเพียง 1.2V
สามารถทำงานกับชิปเซ็ต X99
DDR4 ไม่รองรับการทำงานกับชิปเซ็ต Intel หรือ AMD รุ่นเก่า



KINGSTON Hyper-X Fury DDR4 8GB 2666 Black

Harddisk

ฮาร์ดดิสก์ หรือ จานบันทึกแบบแข็ง (อังกฤษ: hard disk drive) คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุ ข้อมูลแบบไม่ลบเลือน มีลักษณะเป็นจานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วเมื่อ ทำงาน การติดตั้งเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ผ่านการต่อเข้ากับแผงวงจรหลัก (motherboard) ที่มีอินเตอร์เฟซแบบขนาน (PATA), แบบอนุกรม (SATA) และแบบเล็ก (SCSI) ทั้ง ยังสามารถต่อเข้าเครื่องจากภายนอกได้ผ่านทางสายยูเอสบี, สายไฟร์ไวร์ รวมไปถึงอินเตอร์เฟซอนุ กรมแบบต่อนอก (eSATA) ซึ่งทำให้การใช้ฮาร์ดดิสก์ทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อไม่มีคอมพิวเตอร์ถาวร เป็นของตนเอง

คุณสมบัติ SEAGATE BARRACUDA 1TB

ความจุ : 1 TB

Form Factor: 3.5

RPM: 7200

Interface: SATA 3.0

รองรับเทคโนโลยี Seagate's Multi-Tier Caching Technology (MTC)



SEAGATE BARRACUDA 1TB

SSD

SSD ย่อมาจาก Solid state drive คืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับฮาร์ดดิกส์เพียงแต่ หลักการทำงานนั้นแตกต่างจากฮาร์ดดิกส์รุ่นเก่า ซึ่งฮาร์ดดิกส์ SSD ถือได้ว่าเป็นฮาร์ดดิกส์รุ่นใหม่ ที่กำลังมาแรงที่สุด โดยเราสามารถแบ่งฮาร์ดดิกส์ SSD ได้ 2 แบบด้วยกันคือ

- 1. NOR Flash จะมีการเรียงหน่วยความจำแบบขนานเพื่อให้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระและ รวดเร็ว เสียอย่างเดียวมีความจุต่ำและราคาแพงมาก
- 2. NAND Flash สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบที่ละบล็อค แต่มีความจุสูงกว่าแบบแรก ซึ่งแบบนี้จะมี โครงสร้างและลักษณะการทำงานเหมือนกับ Flash Driver ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเองโดยสามารถแบ่ง ออกได้อีก 2 แบบด้วยกัน คือ Single Level Cell(SLC) และ Multi-Level Cell (MLC)

คุณสมบัติ Western Digital WD GREEN M.2 240GM

ความจุ : 240GB

ขนาดSSD : M.2 2280

Interface: M.2 PCIe Gen3



Western Digital WD GREEN M.2 240GM

Power supply

คือ แหล่งจ่ายไฟไปเลี้ยงให้คอมพิวเตอร์ยังสามารถทำงานได้Power supply ที่นำมายกตัวอย่างคือ COOLERMATSTER MWE 550

คุณสมบัติ COOLERMATSTER MWE 550

กำลังไฟ : 550W

Fan size: 120mm

Power Factor Correction : Active Mainboard Connector : 20+4 Pin

CPU Connector : 1 x 4+4 Pin

PCI Ex Connector: 2 x 6+2 Pin

Sata Connector: 6Molex Connector 3

Floppy Connector: 1

สามารถถอดสายได้ : NON Modular

มาตราฐานรับรอง : 80+

ระบบป้องกันไฟเกิน : OVP/OPP/OTP/SCP

รองรับไฟขาเข้า : 200-240 VAC

ขนาด : 140x150x86 mm



COOLERMATSTER MWE 550

Cpu cooler

คือ ระบบที่ช่วยในการระบายความร้อนให้แก่อุปกรณ์ที่เมื่อทำงานแล้วทำให้เกิดความร้อนขึ้นในตัว ซึ่งเป็นการช่วยรักษาอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินกว่าที่อุปกรณ์นั้นจะสามารถทน ได้ เมื่อคอมพิวเตอร์มีการทำงานหรือทำการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ หน่วยประมวลผลกลางจะ ทำงานและทำให้เกิดความร้อนขึ้น ถ้าหากไม่มีการระบายความร้อนออกจากตัวซีพียู จะทำให้เกิด การโอเวอร์ฮีต หรือ อาจทำให้ซีพียูไหม้ ได้ ดังนั้นระบบระบายความร้อน จึงมีความสำคัญต่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบความเย็นของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบความเย็นของแหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ ระบบความเย็นของซีพียู

Case

มีลักษณะเป็นเหมือนกล่องทรงสี่เหลี่ยมทำด้วยโลหะหรือพลาสติกชนิดแข็ง เคสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ บรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์้ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น เมนบอร์ด(Mainboard) แรม (RAM) ซีพียู(CPU) การ์ดจอ(Graphic Card) ฮาร์ดดิสก์(Harddisk)และอื่นๆ โดยทั่วไปเคสจะมี 2 แบบ คือแบบวางแนวนอนหรือแบบเดสท็อป(Desktop) และแบบวางแนวตั้งหรือแบบ(Tower) สำหรับแบบทาวเวอร์นั้นยังแบ่งออกได้อีกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กที่เรียกว่า มินิทาวเวอร์(Mini Tower)

ขนาดกลางหรือมีเดียมทาวเวอร์(Medium Tower) และขนาดใหญ่หรือฟลูทาวเวอร์(Full Tower) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานตามบ้านหรือสำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบมินิทาวเวอร์และมีเดียวทาว เวอร์ส่วนขนาดใหญ่นั้นมักพบในเครื่องเซิฟเวอร์ขนาดเล็ก



AERO COOL CS-1101(Black)

บรรณานุกรม(แหล่งอ้างอิง)

https://downloaddd.in.th/knowledge/computer/graphic-card

http://theprofessional1911.blogspot.com/

https://www.guimee.com/blog/215/I1-I2-I3-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-cpu-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%

B8%A3/

https://www.extremeit.com/intel-tdp-vs-amd-tdp-thermal-design-power/

https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-3-

1200?fbclid=lwAR3pxNR9mMFcKoF8Y61-pb7sd1-QMKwuPsfzAt_EwkxZ1JoHN1C18ia9JAg

https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M-HDV/index.asp#Specification

ภาคผนวก



โอเวอร์คล็อกอัตโนมัติสูงสุด 2666MHz

HyperX*FURY DDR4 สามารถตรวจสอบสถาปัดยกรรมการทำงานที่เสียง ต่ออยู่ด้วยได้อัดโนมัติ และโอเวอร์คล็อกเป็นความถีสูงสุดที่ผอแพช่ สูงสุดที่ 2666Miz การทำงานจึงเหมือนอุปกรณ์ ในความถีสูงสุดที่ผอแพช่ สูงสุดที่ 2666Miz การทำงานจึงเหมือนอุปกรณ์ ในความถีสูงสุดที่ หนีแนบอร์ด Intel 200 series และซิปเช็ต X99 และซิงเสริมการทำงานของโปรเชสเซอร์ 2,4,6,8 และ 10 แกนประมวลผลจาก Intel ทำให้ดัดต่อวิดีโอ เรนเดอร์ ภาพ 3 มิติ ประมวลผลเกมและ AI ได้รวดเร็วชีงกว่า มีจำหน่ายที่ความเร็ว ระหว่าง 2133MHz-2666MHz ค่าหน่างเงลา CL14-16 ความจุ 4G8,8GB และ 16GB แบบแถวเดียว รวมทั้งเป็นชุดชนาด 8G8-64GB HyperX FURY DDR4 คือภารณหน่างแล้วนประกอบระดับพริเมียมในราคาสุดคุมที่ประช รองรับความเร็วและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และเสถียรภาพในการ ทำงานที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะคุดตา ไม่เกิดความ ร่วนในการทำงาน เนื่องจากใช้ไป 1.2Vทำให้มีความร้อนน้อยกว่าและแรง ดันให้ทำสำกว่า DR3 การออกแบบมีสได้ส ครงคำ เสริมความโดดเด่น ให้กับฮาร์ตแวร์ PC รุ่นใหม่ ๆ และซังดูแตกต่างจากเครื่องทั่ว ๆ ไป

- > พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับชิปเซ็ต Intel 200 Series และ X99
- > อัพเกรดมาเป็น DDR4 ประสิทธิภาพสูง ที่คุ้มค่าคุ้มราคา
- > สิ้นเปลืองพลังงานต่ำกว่า DDR3 ที่ 1.2V
- ขึ้นส่วนกระจายความร้อนทรงตำดูมีสไตล์ พร้อมสัญลักษณ์ FURY แบบอสมมาตร





ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับram hyperX Fury DDR4

หน่วยความจำ HyperX FURY DDR4

คุณสมบัติ/ข้อดี

- > Plug and play ปรับความเร็วได้ในระดับที่คุณต้องการอย่างไม่ ยุ่งยาก HyperX FURY DDR4 เป็นผลิตภัณฑ์ขุดแรกที่สามารถโอเวอร์ คล็อกอัตโนมัติตามความถีสัญญาณนาพีกาสูงสุดที่เผยแพร่ไว้
- > พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ Intel 200 Series และชิปเช็ต X99 — Hyperx FURY DDR4 ผ่านการทดสอบ 100% และปริบแต่ง มาเพื่อรองขับการทำงานร่วมกันและโอเอร์คล็อกความเร็วได้ อย่างไม่ยุ่งยาก เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับเมนบอร์ด 200 Series หรือปืนชัด X99 คุณจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยี DRAM ใหม่ล่าสุด หรือ DDR4
- สิ้นเปลืองพลังงานดำ DDR4 ใช้พลังงานน้อยกว่า จึงเกิดความ ร้อนน้อยกว่าและมีเสถียรภาพในการทำงานมากกว่า ใช้ไฟเพียง
 1.2 โวลท์เครื่อง PC จึงเย็นและเงียบมากกว่า
- >ชุดกระจายความร้อนแนวดำมีสไตล์ โดดเด่นจากฝูงชน พร้อมนำเสนอสไตล์ของคุณเองกับชุดกระจายความร้อนแบบ อสมมาตร TRIP ที่ผิดคลังเป็นเหมือนโคร มีรำหน่าย PCB รุ่น สีดำ แดงและขาวสลับคำ FURY DDR4 ใช้ปืนส่วนกระจายความร้อนแนว ดำ สามารถประกอบได้พอศึกับชุดระบายความร้อน CPU ช่วยเสริม การกระจายความร้อนทำใหล่ถืยรภาพในการทำงานยาวหวามยายกระบายความร้อนทำใหล่ถืยรภาพในการทำงานยาวหวามร้อนทำใหล่ถืยรภาพในการทำงานยาวหวามร้อนทำใหล่ดีชรภาพในการทำงานยาวหว่างานยาวหวามร้อนทำใหล่ดีชรภาพในกระทำงานยาวหว่างานยาวหว่าง

รายละเอียดทางเทคนิค

- > ความจุหน่วยความจำขนาด 4GB-16GB แบบแถวเดียวและเป็น ชุดขนาด 8GB-64GB
- >**ความถึ** 2133MHz, 2400MHz, 2666MHz¹
- >ค่าหน่วงเวลา CAS CL14-CL16
- >แรงดันไฟฟ้า 120
- >อุณหภูมิการทำงาน 0°⊂ถึง 85°⊂
- >อุณหภูมิการจัดเก็บ -55℃ถึง 100℃
- >ขนาด 133.35 x 34.04 มม.



เลขขึ้นส่วน

ดา

HX421C14FB/4	HX424C15FB/4	HX426C15FB/4
HX421C14FBK2/8	HX424C15FBK2/8	HX426C15FBK2/8
HX421C14FBK4/16	HX424C15FBK4/16	HX426C15FBK4/16
HX421C14FB2/8	HX424C15FB2/8	HX426C16FB2/8
HX421C14FB2K2/16	HX424C15FB2K2/16	HX426C16FB2K2/16
HX421C14FB2K4/32	HX424C15FB2K4/32	HX426C16FB2K4/32
HX421C14FB/16	HX424C15FB/16	HX426C16FB/16
HX421C14FBK2/32	HX424C15FBK2/32	HX426C16FBK2/32
HX421C14FBK4/64	HX424C15FBK4/64	HX426C16FBK4/64

ขาว

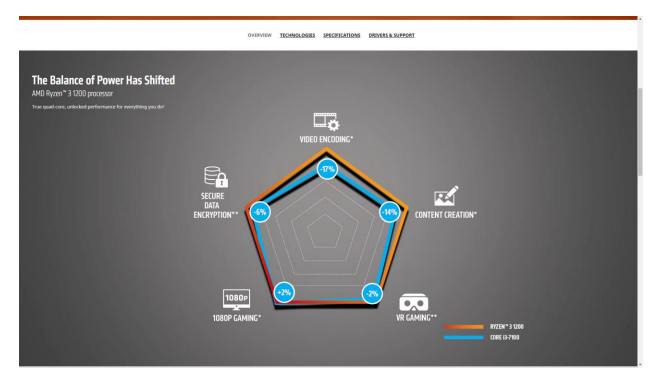
HX421C14FW2/8	HX424C15FW2/8	HX426C16FW2/8
HX421C14FW2K2/16	HX424C15FW2K2/16	HX426C16FW2K2/1
HX421C14FW2K4/32	HX424C15FW2K4/32	HX426C16FW2K4/3
HX421C14FW/16	HX424C15FW/16	HX426C16FW/16
HX421C14FWK2/32	HX424C15FWK2/32	HX426C16FWK2/32
HX421C14FWK4/64	HX424C15FWK4/64	HX426C16FWK4/64

แดง

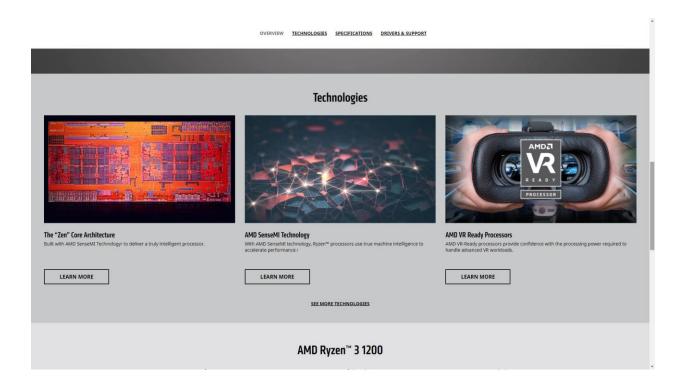
and a		
HX421C14FR2/8	HX424C15FR2/8	HX426C16FR2/8
HX421C14FR2K2/16	HX424C15FR2K2/16	HX426C16FR2K2/1
HX421C14FR2K4/32	HX424C15FR2K4/32	HX426C16FR2K4/3
HX421C14FR/16	HX424C15FR/16	HX426C16FR/16
HX421C14FRK2/32	HX424C15FRK2/32	HX426C16FRK2/32
HX421C14FRK4/64	HX424C15FRK4/64	HX426C16FRK4/64







ค้นหาข้อมมูลเกี่ยวกับ AMD Ryzen 3 1200



ศึกษา เทคโนโลยีของ AMD Ryzen 3 1200



ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ AB350M-HDV





ค้นหลข้อมูลเกี่ยวกับ SEAGATE BARRACUDA 1TB

สรุป

Ram

คุณสมบัติ/ข้อดี

- Plug and play HyperX FURY DDR4 เป็นผลิตภัณฑ์ชุดแรกที่ สามารถโอเวอร์คล็อก อัตโนมัติตามความถี่สัญญาณนาพิกาสูงสุด ที่เผยแพร่ไว้ปรับความเร็วได้ในระดับที่คุณต้องการ อย่างไม่ยุ่งยาก
- พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำ หรับชิปเซ็ต Intel 100 Series และ X99 เทคโนโลยี DRAM ใหม่ ล่าสุดสำ หรับชิปเซ็ต 100 Series และ X99 หน่วยความจำ HyperX FURY DDR4 ผ่านการทดสอบ 100% และรองรับการทำ งานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถโอเวอร์คล็อก ได้ง่าย
- สิ้นเปลืองพลังงานต่ำ HyperX FURY DDR4 ใช้พลังงานน้อยกว่า จึงเกิดความร้อนน้อยกว่า และมีเสถียรภาพในการทำ งานมากกว่า ใช้ไฟเพียง 1.2 โวลท์เครื่อง PC จึงเย็นและเงียบมากกว่า
- ชุดกระจายความร้อนแนวต่ำ มีสไตล์ โดดเด่นจากฝูงชนพร้อม นำ เสนอสไตล์ของคุณเองกับ ชุดกระจายความร้อนแบบอสมมาตร FURY ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร มีจำ หน่ายสีดำ กับ PCB สีดำ หน่วย ความจำ FURY DDR4 ช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับเมนบอร์ดที่ติด ตั้งชิปเซ็ต Intel 100 Series หรือ X99

Mainboard

Unique Feature

ASRock Super Alloy

- High Density Glass Fabric PCB
- Sapphire Black PCB

ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)

ASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports)

ASRock Live Update & APP Shop

CPU

- Supports AMD Socket AM4 A-Series APUs (Bristol Ridge) and Ryzen Series CPUs (Summit Ridge and Raven Ridge)
- Digi Power design
- 7 Power Phase design
- Supports CPU up to 65W

Chipset

- AMD Promontory B350

Memory

- Dual Channel DDR4 Memory Technology
- 2 x DDR4 DIMM Slots
- AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
- AMD 7th Gen A-Series APUs support DDR4 2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
- Max. capacity of system memory: 32GB**
- 15µ Gold Contact in DIMM Slots

BIOS

- 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 5.1 compliance wake up events

- Supports jumperfree
- SMBIOS 2.3 support
- DRAM Voltage multi-adjustment

Graphics

- Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen Series APU*
- Integrated AMD Radeon™ R-Series Graphics in A-series APU*
- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB.**
- Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
- Supports Triple Monitor
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160)
 30Hz
- Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 2048x1536 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP 1.4 with DVI-D and HDMI Ports
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D and HDMI Ports
- *Actual support may vary by CPU
- **The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory installed.

Audio

- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)

- Supports Surge Protection
- ELNA Audio Caps

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

Slots

AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge and Pinnacle Ridge)

- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*

AMD 7th A-Series APUs / Raven Ridge CPUs

- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*

AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge)

- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*

AMD Athlon series CPUs

- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x4 mode)*
- 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot

^{*}Supports NVMe SSD as boot disks

Storage

- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU, and Athlon 2xxGE series APU)*

*Supports NVMe SSD as boot disks

Supports ASRock U.2 Kit

Connector

- 1 x Print Port Header
- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
- 1 x CPU Fan Connector (4-pin)*
- 2 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 4 pin 12V Power Connector
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.1 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) (Supports ESD Protection)

^{*}The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.

Rear Panel I/O

- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x D-Sub Port
- 1 x DVI-D Port
- 1 x HDMI Port
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
- 4 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

Software and UEFI

Software

- ASRock A-Tuning
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast LAN

UEFI

- ASRock Full HD UEFI
- ASRock Instant Flash
- ASRock Easy RAID Installer

Support CD

- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar

Accessories

^{*}These utilities can be downloaded from ASRock Live Update & APP Shop.

- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 2 x SATA Data Cables
- 1 x Screw for M.2 Socket

Hardware Monitor

- CPU, Chassis temperature sensing
- CPU, Chassis Fan Tachometer
- CPU, Chassis Quiet Fan
- CPU, Chassis Fan multi-speed control
- CASE OPEN detection
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Form Factor

- Micro ATX Form Factor: 9.1-in x 8.1-in, 23.1 cm x 20.6 cm
- Solid Capacitor design

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certifications

- FCC, CE
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

HARDDISK

จุดเด่นของ Hard Disk ลูกนี้นอกจากความจุเยอะแล้ว การรับส่งข้อมูลยังทำได้เร็วโดยสามารถรับข้อมูล รวดเร็ว ส่วยการหมุนของ Hard Disk ยังคงเป็นแบบ 7200 รอบต่อนาที รองรับเทคโนโลยี Seagate's Multi-Tier Caching Technology (MTC) ผสมผสานการทำงานในรูปแบบ NAND เหมือนกับ และทนทาน Cpu http://www.quickpconline.com/pc/pr-news/amd-ryzen-3-warith-max-rgb-cooling/